

# 0.50mm 高速接头 QTH 系列

## 技术规格

如需了解完整技术规格以及所建议的 PCB 布局, 请浏览 [www.samtec.com?QTH](http://www.samtec.com?QTH)

- 绝缘材料:  
液晶  
聚合物  
端子材料:  
磷青铜  
电镀:  
在 50μ" (1.27μm) 的镍上镀金  
额定电流:  
触点: 30°C 温升时为 1.0A  
接地板: 30°C 温升时为 7.8A  
工作温度范围:  
-55°C 至 +125°C  
额定电压:  
125 VAC (5mm 堆叠高度)  
最大次数:  
100  
拔出力 (-RT1 选择): -RT1  
选择增加  
拔出力多达 50%  
符合 RoHS 规范要求:  
是



加工:  
最大加工温度:  
230°C 下持续 60 秒, 或  
260°C 下持续 20 秒, 3 次  
可无铅焊接:  
是

SMT 引线共面性:  
(0.10mm) .004" 最大 (030-060)  
(0.15mm) .006" 最大 (090-120)  
电路板相叠:  
有关每块电路板需要两个连接器  
或 4 列或更多列的应用,  
请联系 [ipg@samtec.com](mailto:ipg@samtec.com)

## 特定应用的选择

- 14mm、15mm、22mm 和 30mm 堆叠高度 (小心: 有些自动放置/插入机械可能有元件高度限制。请参考机械技术规格。)
- 30μ" (0.76μm) 的金 (为数据速率线缆配接应用指定 -H 电镀。)
- 边缘安装和导柱
- 每排 150 个位置  
请致电 Samtec。

\*注: -C 电镀通过 10 年 MFG 测试

注: 某些长度、式样和选择为非标准型, 不可退换。

电路板配接:  
QSH

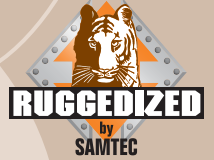
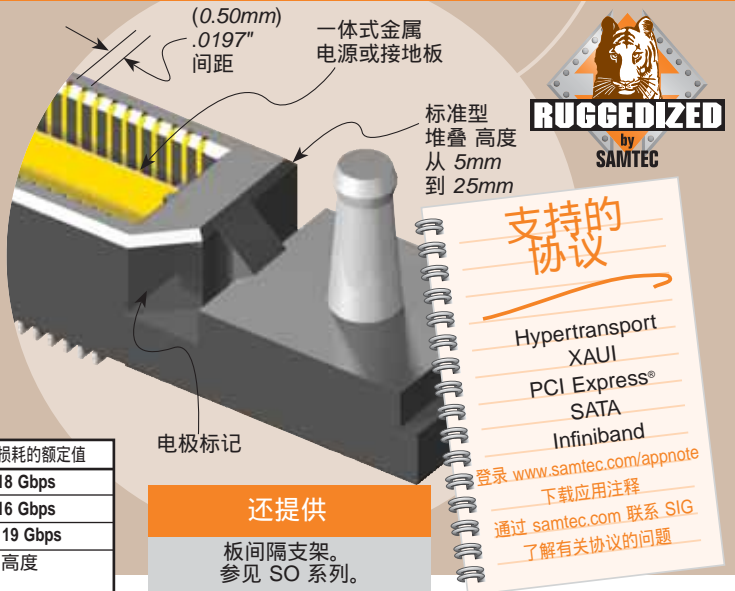


缆线配接:  
HFHM2、HQCD、HQDP  
(参见特定应用的注释)



5mm 堆叠高度	类型	在 -3dB 插入损耗的额定值
单端信号	-D	9 GHz / 18 Gbps
差分对信号	-D	8 GHz / 16 Gbps
差分对信号	-DP	9.5 GHz / 19 Gbps

还在 [www.samtec.com?QTH](http://www.samtec.com?QTH) 提供其他堆叠高度的性能数据

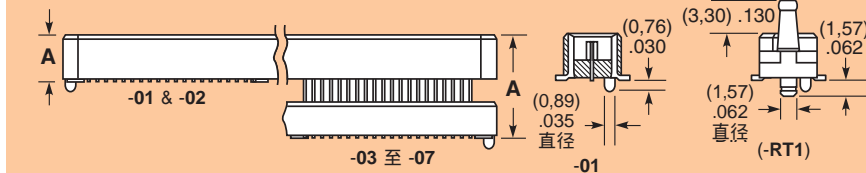
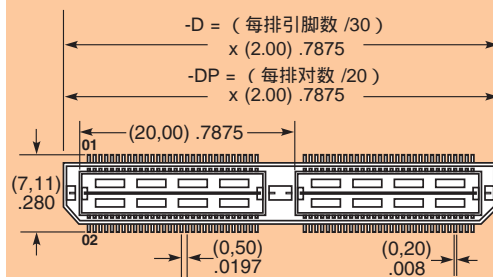


支持的协议

- Hypertransport XAUI
- PCI Express
- SATA
- Infiniband

登录 [www.samtec.com/appnote](http://www.samtec.com/appnote)  
下载应用注释  
通过 [samtec.com](http://samtec.com) 联系 SIG  
了解有关协议的问题

QTH	每排引脚数对数	引线式样	电镀选择	类型	A	其它选择
	-030, -060, -090, -120 (每列总共 60 个引脚 = -D)	从图表中指定引线式样	-L = 在信号引脚和接地板上镀 10μ" (0.25μm) 的金 焊尾镀雾锡	-D = 单端 -D-DP = 差分对 (仅限 -01)		-K = (7.00mm) .275" 直径聚乙烯酰亚胺膜取放垫 -TR = 卷带 (-090 最大位置数) -RT1 = 固定选择 (仅限 -01 引线式样和 -090 最大位置数)
	-020, -040, -060, -080 (每列 20 对 = -D-DP)		-F = 信号引脚和接地板上镀金膜, 焊尾镀雾锡			
			-C* = 可选电镀 在触点区域的信号引脚上镀 150μ" (3.81μm) 的镍, 之上最少镀 50μ" (1.27μm) 的金, 在触点区域的接地板上镀 50μ" (1.27μm) 的镍, 之上最少镀 10μ" (0.25μm) 的金, 在所有焊尾上镀最少 50μ" (1.27μm) 镍, 之上镀雾锡			



QTH 引线式样	A	与 QSH 的高度
-01	(4,27) .168	(5,00) .198
-02	(7,26) .286	(8,00) .316
-03	(10,27) .404	(11,00) .433
-04	(15,25) .600	(16,00) .630
-05	(18,24) .718	(19,00) .748
-07	(24,24) .954	(25,00) .984